

IEC 60191-6-18
(Edition 1.0 – 2010)

**MECHANICAL STANDARDIZATION OF
SEMICONDUCTOR DEVICES –**

**Part 6-18: General rules for the preparation of
outline drawings of surface mounted
semiconductor device packages –
Design guide for ball grid array (BGA)**

CEI 60191-6-18
(édition 1.0 – 2010)

**NORMALISATION MÉCANIQUE DES DISPOSITIFS
À SEMICONDUCTEURS –**

**Partie 6-18: Règles générales pour la préparation
des dessins d'encombrement des dispositifs à
semiconducteurs pour montage en surface –
Guide de conception pour les boîtiers matriciels
à billes (BGA)**

C O R R I G E N D U M 2

3.1
ball grid array
BGA

This correction applies to the French only.

3.1
boîtier matriciel à billes
BGA

*Remplacer la note existante par la
nouvelle note qui suit:*

NOTE Dans la présente norme, BGA signifie
« Boîtier matriciel à billes », nom conforme
aux normes existantes (Voir Bibliographie).

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

[IEC 60191-6-18:2010/COR2:2010](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/70dc3965-a5dc-4821-a9c0-7af40063bf83/iec-60191-6-18-2010-cor2-2010)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/70dc3965-a5dc-4821-a9c0-7af40063bf83/iec-60191-6-18-2010-cor2-2010>